國立臺灣科技大學工程學院半導體產業學程（研究所）修讀辦法

102年6月4日第168次教務會議通過

105 年 6 月 7 日第 182 次教務會議通過

111年2月10日第工程學院第98 次課程委員會議通過

112年5月19日111學年度工程學院第5 次課程委員會議通過

112年11月29日112學年度工程學院第2 次課程委員會議通過

1. 凡本校、臺灣大學及臺灣師範大學三校研究生皆可修讀本學程。
2. 招收名額：不限制（但仍受課程之選修人數限制）。
3. 申請方式：應於本校行事曆規定期間提出申請。
4. 最低修習學分總數：附表所列科目至少十二學分。
5. 應修科目及學分數：如附表。
6. 學生修習本學程課程，應於每學期加退選期間內辦理之。
7. 學生修習本學程課程之學分併入各系規定之畢業最低總學分數內，並併入每學期修習之學分上限內。

八、學生修畢本學程應修課程且成績及格者，應於畢業前填具申請表，並檢附歷年成績單影本，依規定時限提出申請，經工程學院半導體產業學程審查委員會審查通過後，由學院發給學分學程修業證明。

九、有關外校學生申請修讀相關事宜，悉依本校公告資訊辦理。

十、本辦法未規定之事宜，悉依本校學則及相關法令之規定辦理。

十一、本辦法經本校教務會議通過後報請校長核定後實施，修正時亦同。

附表 半導體產業學程（研究所）應修科目及學分數

| **課程名稱 (任選四(含)以上)** | **開課系所** | **學分** |
| --- | --- | --- |
| 半導體元件理論 | 電子系 | 3 |
| 半導體元件製造工程 | 電子系、光電所 | 3 |
| 類比積體電路分析與實作 | 電機系 | 3 |
| 嵌入式作業系統實作 | 電機系 | 3 |
| 嵌入式微處理器系統設計 | 電機系 | 3 |
| 嵌入式系統軟體設計 | 電機系 | 3 |
| 創意性機構設計 | 機械系 | 3 |
| 光機電工程學 | 機械系 | 3 |
| 微奈米製造技術 | 機械系 | 3 |
| 真空薄膜工程 | 機械系/材料系/化工系 | 3 |
| 高等材料熱力學 | 材料系 | 3 |
| 穿透式電子顯微鏡 | 材料系 | 3 |
| 積體電路製造程序與設備 | 材料系/機械系 | 3 |
| 半導體元件之製造技術 | 化工系 | 3 |
| 自動化感測與智慧資料擷取 | 自控所 | 3 |
| 微影光學 | 自控所 | 3 |
| 微奈米製造技術 | 機械系 | 3 |
| 半導體製程設備與技術 | 自控所 | 3 |
| 電力電子應用 | 電機系 | 3 |
| 智慧精微及半導體製造(一) | 機械系 | 3 |
| 智慧精微及半導體製造(二) | 機械系 | 3 |
| 計算機演算法 | 電子系 | 3 |